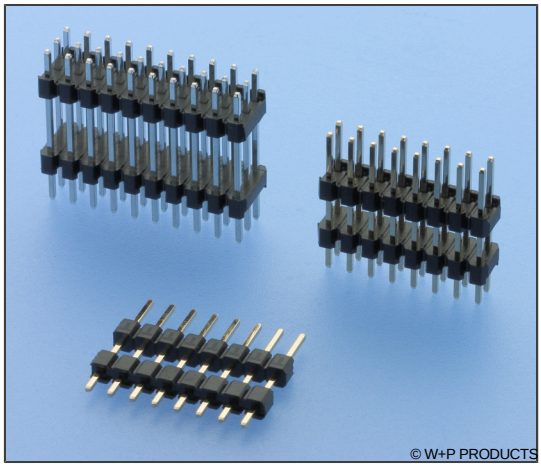
949 / 950 / 951

Sandwich-Stiftleisten RM 2,54mm, 1-/2-/3-reihig

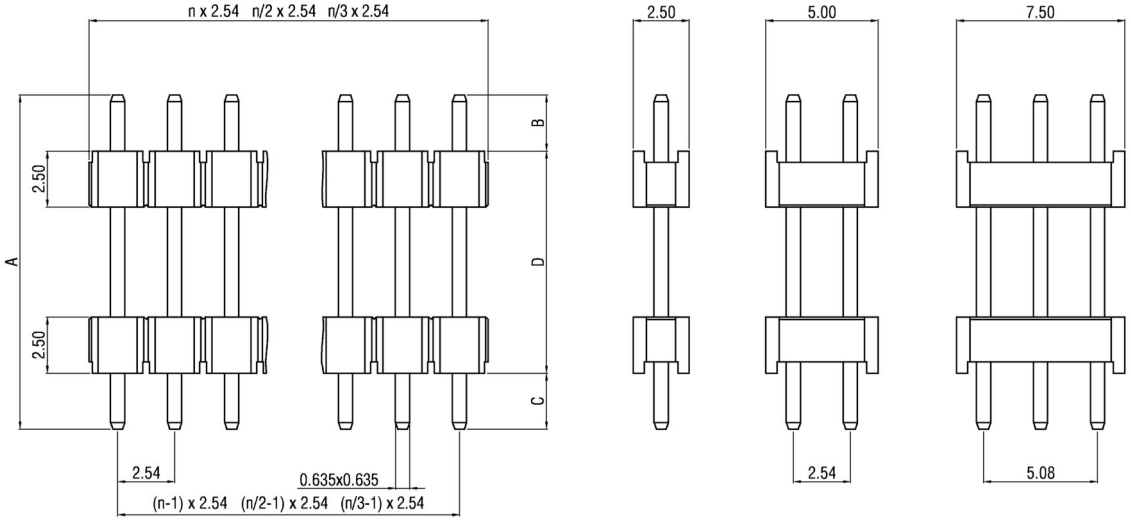
Dual Body Pin Headers, 2.54mm Pitch, 1/2/3 Rows

Technische Daten / *Technical Data*

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung
Contact Material	*0.635mm square pin, copper alloy*
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	*Acc. to options (see below), over Ni*
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c	keine
RoHS Exemptions 6a-I / 6c	*none*
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	*< 20 mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	*> 1000 MΩ*
Spannungsfestigkeit	1 kV DC
Withstanding Voltage	*1 kV DC*
Nennspannung	250 V AC
Voltage Rating	*250 V AC*
Nennstrom	3 A
Current Rating	*3 A*
Temperaturbereich	-40 °C ... +125 °C
Temperature Range	*-40 °C ... +125 °C*
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	*Wave or reflow soldering*



Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
153 154 157 159 160/162 349 624 etc.
Weitere siehe Kapitel B
Please see ch. B for more



PCB Layouts und Detailzeichnungen s. tech. Informationen / Seite A12
Please note tech. information / page A12 for PCB layouts and detailed drawings.

Series *

949

Gestanzte/geprägte Kontakte
Stamped/formed contacts
949 Einreihig
Single row
950 Zweireihig
Double row
951 Dreireihig
Triple row

Dimensions *

19

16 A=17,70 B=5,70 C=3,30 D=8,70mm
17 A=19,80 B=5,70 C=3,30 D=10,80mm
18 A=21,60 B=5,70 C=3,30 D=12,60mm
19 A=22,80 B=5,70 C=3,30 D=13,80mm
20 A=24,90 B=5,70 C=3,30 D=15,90mm
21 A=26,70 B=5,70 C=3,30 D=17,70mm
22 A=29,00 B=5,70 C=3,30 D=20,00mm
23 A=30,80 B=5,70 C=3,30 D=21,80mm
24 A=37,80 B=5,70 C=3,30 D=28,80mm
25 A=40,80 B=5,70 C=3,30 D=31,80mm
26 A=45,30 B=5,70 C=3,30 D=36,30mm
A/B/C/D Gesamtlänge & Wunschmaße
Total length & Dimensions

Contacts *

010

001-050 Einreihig
Single row
004-100 Zweireihig
Double row
006-120 Dreireihig
Triple row

Plating *

00

00 Au flash
110 Sel. Au 0,25µm / flash
130 Sel. Au 0,75µm / flash
50 Sn
66 Sel. Au flash / Sn
610 Sel. Au 0,25µm / Sn
80 Sel. Au 0,75µm / Sn
Au flash <= 0,1µm
Au flash <= 0,1µm

B, C, D nach Kundenwunsch variierbar. Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl. Raster 5,08mm, 7,62mm, etc. oder Sonderraster auf Anfrage. Bestellseite "Sonderbestückungen bei Stiftleisten" unter Techn. Informationen.

B, C, D variable acc. to custom specifications. We will manufacture pin headers in thedesired number of contacts. 5.08mm, 7.62mm, etc. and varying pitches on request. Order page "Customer-specific Pin Configurations" in Technical Information.

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.

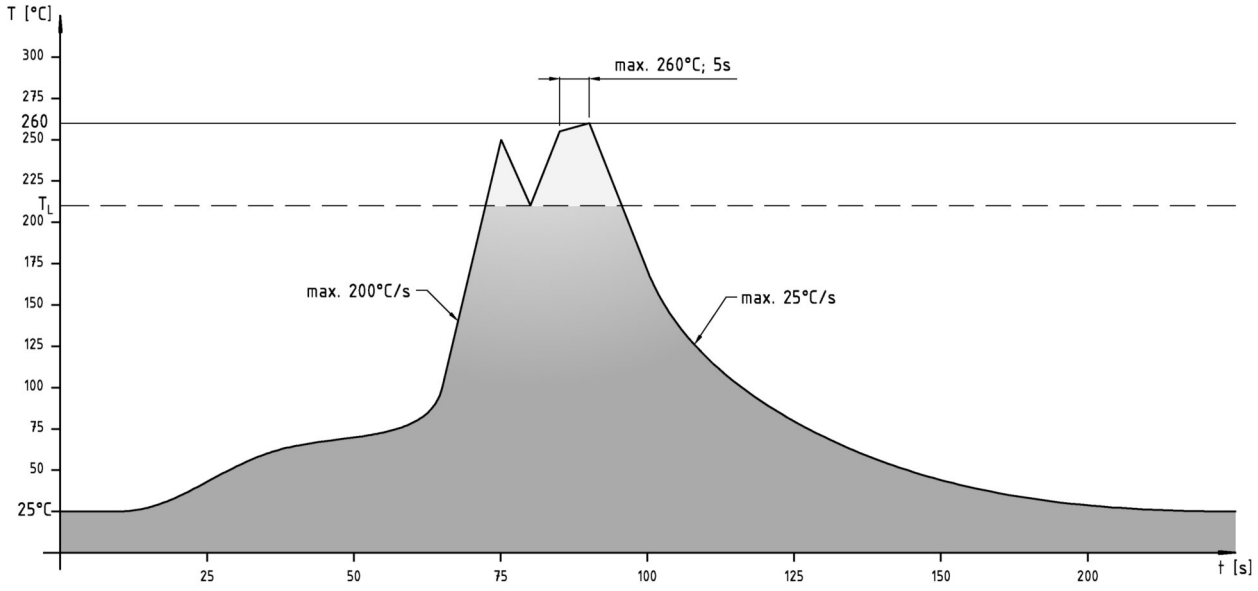
Downloaded from Arrow.com.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren
Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Empfohlenes Wellenlötprofil:



Downloaded from Arrow.com.

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

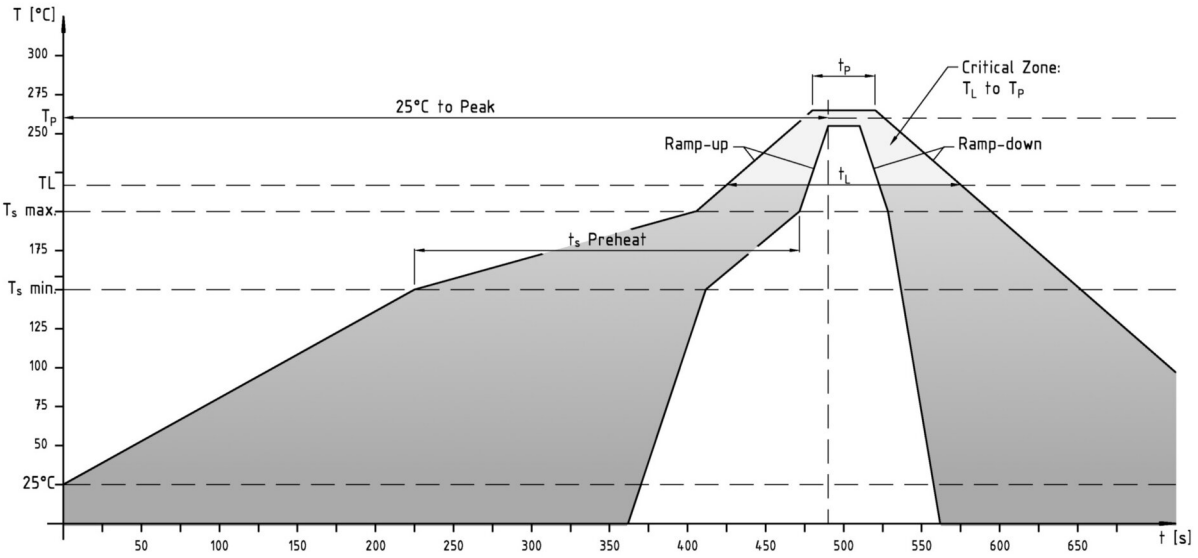
Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_S$min	150 °C
Temperatur Maximum $T_S$max	200 °C
Dauer $T_S$min – $T_S$max	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_S$min	*150 °C*
Maximum Temperatur $T_S$max	*200 °C*
Duration $T_S$min – $T_S$max	*60 – 180s*
Soldering Range Temperature T_L	*217 °C*
Duration above T_L	*60 – 180s*
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	*max. 3 °C / s*
Peak Temperature T_P	*260±5 °C*
Duration Peak Temperature	*20 – 40s*
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	*6 °C / s*
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	*max. 8min*



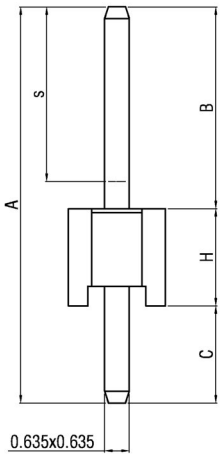
Downloaded from Arrow.com.

143 - 151 / 943 - 951 / 921 - 934

Gerade Stiftleisten / Straight Pin Headers

A : Gesamtstiftlänge / *Overall Pin Length*
B : Länge Steckseite / *Mating Side Length*
C : Länge Lötseite / *Solder Side Length*
H : Höhe Isolierkörper / *Insulator Body Height*
s : Bereich der sel. Veredelung / *Sel. Plated Area*

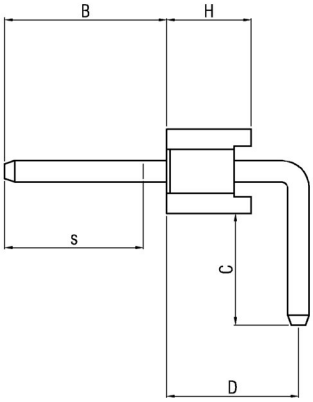
Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze.
Test point for s at 2-4mm from contact tip.



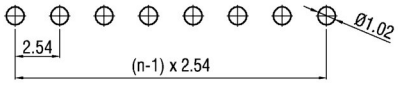
Gewinkelte Stiftleisten / Right-Angled Pin Headers

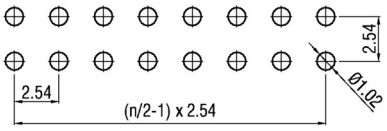
B : Länge Steckseite / *Mating Side Length*
C : Länge Lötseite / *Solder Side Length*
D : Abstand zu Steckseite / *Distance to Mating Side*
H : Höhe Isolierkörper / *Insulator Body Height*
s : Bereich der sel. Veredelung / *Sel. Plated Area*

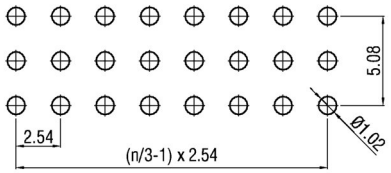
Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze.
Test point for s at 2-4mm from contact tip.



PCB Layouts







Downloaded from Arrow.com.